TG300

耐高温导热硅脂

TG300是一款具有高导热系数耐高温的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料，耐热性、长效性、可靠性佳，同时低BLT厚度可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻，适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。



特性和优点

- 导热系数3.0W/(m·K)
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻
- 耐候性强（耐高低温、耐水气、耐老化等）

典型应用

- 存储模组
- 网络通讯设备
- 消费类电子
- 电源
- 工控设备
- 电控、OBC等汽车电子

典型属性		
属性	**典型值**	**测试方法**
颜色	灰色	目视
密度(g/cc)	3.2	ASTM D792
BLT(μm)	15	千分尺
挥发份(%)	≤0.5	@125°C, 48h
粘度(cP)	≤200000	DV2T-T93-12Rpm
耐温范围(°C)	-40~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度＜40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5.0	ASTM D149
体积电阻率(Ω・cm)	10^{12}	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	3.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in^2/W @50psi,80°C)	≤0.015	ASTM D5470

在本文档中提供的任何信息都被认为是准确的。所有规格如有更改，恕不另行通知。所有产品和服务均按销售条款和条件出售。卖方或制造商均不对侵权行为或合同中的任何直接，偶然或后果性损失或损害承担责任，包括因使用或无法使用产品而造成的利润或收入损失，除非卖方和制造商的官员签署协议，否则此处未包含的卖方或购买方的任何声明，采购订单或建议均不具有任何效力。
©版权所有2019，AOCHUAN TECHNOLOGY。

AOK 傲川科技 AOCHUAN TECHNOLOGY